

## **CF06-Ensamble de tarjetas electrónicas según especificaciones y normativa técnica**

**Planificación del ensamble de tarjetas electrónicas:** Se realiza según la naturaleza de la tarjeta a ensamblar, es necesario contar con los planos y la documentación completa del proyecto

**Equipos de ensamblaje electrónico:** Estaciones de soldadura, hornos de reflujo, equipos de soldadura por ola, máquinas de posicionamiento automático

**Técnicas y sistemas de microscopía óptica y ampliación de imágenes:** establece normas internacionales para inspeccionar como la IPC 610E

**Funcionalidades y características de accesorios:** accesorios que pueden ser utilizados para ensamblar tarjeta

**Métodos de uso, procesos de ensamble, accionamiento y configuración:** Ensamble electrónico y ensamble manual.

**Soldadura en electrónica:** máquinas de posicionamiento automático, Pick and Place

**Técnicas, tipos y propiedades de aleaciones y aceleradores:** soldadura con plomo y libre de plomo

**Métodos de uso y mantenimiento de herramientas:** limpieza, consideraciones.

**Características de soldabilidad:** diseñados para asegurar la solubilidad con el estaño

**Técnicas de retiro y limpieza de excesos:** los restos de fundente son extremadamente peligrosos

**Tratamiento térmico:** es importante conocer las características específicas térmicas de cada elemento

**Efectos del calor en componentes electrónicos:** Cada componente tiene parámetros que indican las temperaturas máximas que puede aguantar

**Técnica de reflujo:** derretir la soldadura puesta previamente sobre los pads de la tarjeta

**Perfil ideal de temperatura:** zonas de precalentamiento, activación, fundición, enfriamiento